

2024年3月期第二四半期 アナリスト・機関投資家向け WEB 説明会 質疑応答要旨

株式会社フェローテックホールディングス(6890)

◇ 開催日時：2023年12月6日（水） 16:00-17:00

Q1: 子会社 IPO の時期について、今回資料では CCMC 上場時期が 2024 年に変更になっていた。来年は FTNC も上場予定と記載されているが、1 年で 2 社も上場できるのかも含め、IPO の状況について説明してほしい。

A1: 中国では 8 月 23 日に IPO に関して新しい政策が出てきた。これから IPO の審査を厳しくする、今の IPO の数は多いし、株価も低い、ということのようである。CCMC は科创板に上場予定だが、科创板での上場も以前よりは厳しくなってきた。もともとは、国が奨励する事業は早く上場させる傾向にあったが、今は逆にスピードを落としている。今のスピードだと年間 100 社ぐらいしか上場できないのではないともいわれ、IPO の期間もどんどん長期化しており、現時点で我々の上場がいつぐらいにできるかは何とも言えない。

CCMC では取引所審査時の 2 回の質問は既に終わっていて、今年の子測数値や来年の予定数値も既に提出済みという状況。スケジュールについては取引所の判断に委ねられる。

FTNC の業績は年初計画よりは良い状況で、IPO 審査は 1 回目の質問が終わり間もなく関係書類を開示予定で、その開示の後 2 回目の質問が来るとされる。手続きは順調に進んでいるが、ただ IPO のスピードは落している状況なので、今までどおりのスピードでの上場は難しいかもしれないと取引所からも言われている。

Q2-1: 半導体等装置関連の事業で中国ローカルメーカーとの取引が広がっているとのことだが、中国の割合は半分くらいとの認識か？

A2-1: おっしゃる通り、半導体等装置関連の大体半分くらいは中国での売上である。特に今期は米系大手からの受注がマイナスになったのをカバーするかたちとなっている。

Q2-2: マレーシアの工場が稼働により米系大手への納入シェアが変わってくるのか？また、来年の半導体市場の回復時期が 3Q と聞いたが、7～9 月を指すのか？10～12 月か？

A2-2: マレーシアの現状だが、(北部、クリムの)工場はほとんど完成し、あとは装置の据付のみであり、来年 1 月から生産開始をしたいと思っている。マレーシアでは、中国で造らないものを製造し納入する。なお、3Q といっているのは 7～9 月のことを指す。

Q3: パワー半導体基板について、今期少し利益率が下がったようだが、現状の分析と今後の成長軌道に乗せる、収益改善をするか見通しについて教えてほしい。

A3: パワー半導体基板は8月迄急速な成長をしてきたが、その後11月半ばまでは一服、11月後半から持ち直し、12月には想定通りの成長軌道に戻った。今期の売上は346億円、年初計画の360億円よりちょっと下回る。ただ、今の見立てでは今後パワー半導体基板の事業はそんなに下がることはなく、逆にどんどん増えていくとみている。特に車載のところは、認定の期間は長いですが、現状試作はもう終わって本採用の段階に移行すると見ており、来年は少なくとも2~3割は成長できると見ている。EV（電気自動車）市場の良し悪しの影響はあっても中長期の傾向は変わらないと思う。

Q4: 太陽光向け石英坩堝（るつぼ）については、今回決算で計画が大きく変わったが、その状況について教えてほしい。

A4: 一時的には落ち込む見込みだが、それでも対前年で急速に成長してきた。太陽電池向け石英坩堝はコスト面以外にも、例えば使用可能時間については従来200時間が、300時間、400時間、500時間と伸びるなど要求度が高くなっており、性能・品質面での苦労もある。そうした課題を解決していき、来年1Qから成長軌道に戻したい。

また、今の石英坩堝の価格は高騰しており、原因である石英パウダーの価格が正常化したら、石英坩堝の価格もあわせていくことになる。おそらく来年ぐらいには正常化すると思っている。

Q5: 中計資料P24、2025年3月期の売上高2,700億円、営業利益450億円を目指すとのことだが、半導体市場の回復見通しが2024年の半ば以降という見方に対して、どうやって大きく伸ばすことができるのか？市場の伸びに比して大きく伸びる要因を教えてほしい。

A5: 半導体等装置関連では、石英は今年の火加工の能力強化に取組み、職人600人体制を築いた。来年は火加工品で3割ぐらい伸ばせると思う。機械加工品も海外顧客で伸ばして、石英全体では25%ぐらい伸ばせると思う。セラミックスは中国国内で3割ぐらい、海外も半導体の景気が戻ってきたら少しは伸びるのではないかと思う。CVD-SiCは、常山工場が立ち上がる。売上貢献は2024年7月からで、これは純粋にプラスになる。日本のCVD-SiCも15%ぐらいの成長と見ている。金属受託加工は、マレーシアの工場は40億円ぐらい、中国国内でも2割ぐらい伸ばせると思う。この11月から真空チャンバーやロボットのスペアパーツや組立ての仕事が入って来ている。石英坩堝（るつぼ）もかなり成長貢献できる。シリコンパーツは海外市場の更なる開拓を目指す。

電子デバイスでは、パワー半導体基板は2~3割の成長、かつ材料開発をできたので自社供給できることも収益に貢献し、かつ供給のボトルネックも改善できる。サーモモジュールは、自動車関連でEVの通信関連で熱発生する部分の冷却で多く使う。車載冷蔵庫もEVで普及すると見ており、今4社ぐらいの試作で成功しているし、今後かなり台数は出てくると考えている。（飲料保冷用の）コールドカップもどんどん出ると思う。ChatGPT（生成AIサーバー）関連で使う光トランシーバーは増えていく

と思う。これから 800GB タイプが増えているが、来年には最先端の 1.6TB タイプが出てきて増えると思っている。あとチラーは市場投入したが評価は良く、これも増やせると思う。

我々はいろいろ工夫をしており、これで売上高 2,700 億円は行けるのではないかと考えている。

Q6: あと、P14 のスライドで半導体等装置関連は 1,267 億円の計画だが、このうち中国ローカル向けの売上高は半分ぐらいで 600 億円ぐらいという認識でよいのか？また、去年はどのぐらいで、来年はどのぐらいになりそうか？

A6: 中国国内売上というとらえ方で 600 億円ぐらい。前年では 500 億円ぐらい、来年は 2～3 割伸びると見ている。

Q7: パワー半導体基板は中国比率が高いとの認識だが、今後マレーシアの工場ができると、純粋に顧客層が広がるのか？

A7: おっしゃる通り、中国が減るというよりは、純粋に顧客層が広がると見ている。ちなみに、マレーシア工場（南部、ジョホールバル）ができると、（中国と合わせ）DCB 基板は 200 万枚/月、AMB は 100 万枚/月の生産能力になる。あと、DPC 基板も増えてきている。

Q8: 熊本では洗浄と石英の事業をすると聞いているが、この工場への期待を教えてください。

A8: 部品洗浄については、熊本ではデバイスメーカーが 4 社、装置の会社が 1 社あり能力としては十分と見るが、若干足りないくらいかもしれない。石英は火加工と機械加工をやる予定で、そこまで大きな能力ではないものの、現時点では大丈夫ではないかと思っている。熊本工場は来年いっぱいできるように頑張って建設を進めている。今後は事業動向を見て、必要であれば順次増設していく。

Q9-1: 光トランシーバー向けのサーモジュールについて今期、来期の売上、利益率などを教えてください。

A9-1: 2023 年通期で 30～40 億円ぐらいとの認識、去年はその 3 分の 1 以下、来年は 2 倍ぐらいだろう。利益率は平均よりは高い。

Q9-2: 通信容量別で 100～800GB、1.6TB などへの構成比はどのぐらいか？わかる範囲で教えてください。

A9-2: 現状半分ぐらいが 800GB で今後更に割合が増えていくと思う。来年は 1.6TB が出るが、それらにシフトするのは時間がかかるだろう。

Q9-3: 米国向けと中国向けの比率は？米国向けの方が多いか？また、今後伸びるのは米国向けか？

A9-3: 当社顧客は米国向け輸出が多いようだ。きちんと集計したわけではないがイメージ 6 割米国、3 割中国、他で 1 割ぐらい。ただ、中国向けの伸び率の方が今後高いと思う。ちなみに日本はまだまだ少ない。

Q10-1: パワー半導体基板の売上の DCB と AMB 構成比について、今期と来期見通しを教えてください。

A10-1: 今期は売上比で DCB : AMB = 2 : 1 ぐらいだが、来期は 6 割が AMB になると思う。顧客は EV メーカー、電機メーカー向けが多い。

Q10-2: 利益率は AMB の方が高いか？

A10-2: AMB の方が利益率は高い。

Q10-3: すると来期はパワー半導体基板全体の利益率が良くなるという見方でよいか？

A10-3: おっしゃるとおりだ。

※ 本資料は当社の「ディスクロージャーの方針」に基づき、「フェア・ディスクロージャー」の観点から、IR 室 IR・広報部にて、まとめさせて頂きました。

以上